

tsmc

模組副工程師招募 線上說明會



日期：2/23、3/16、3/30
時間：19:00~20:00PM



∴線上徵才說明會時間∴

- 2/23(三) 19:00 - 20:00 (已截止)
- 3/16(三) 19:00 - 20:00
- 3/30(三) 19:00 - 20:00

邀請主管與 HR 一起揭開 MAE 的職務內容，
帶領大家一窺台積電「機台守護者」的神秘樣貌

歡迎具備大學學歷且為 電機 / 電子 / 機械 / 自
動控制 / 冷凍空調工程 ... 等相關科系的你，

加入模組副工程師的行列，成為推動半導體領域
解決問題的工程專業人才！



線上講座 報名傳送門

2022 校外實習 台積電 模組副工程師

實習資訊 · 期間：2022/07-2023/06

- 名額：20位

徵才條件 · 2022/07升大四（2021為大三生）

- 電機、電子、機械、光電科系
- 需有機械相關的基礎知識；有半導體製程知識者尤佳
- 具備問題解決、溝通表達、團隊精神、主動學習等能力
- 具備基本英文讀寫能力
- 能配合大多數工作時間內，穿著無塵衣且將在無塵室環境中工作

工作內容 · 負責半導體產品線機台設備維修及保養

- 管理及改善機台零件系統、包含廠商與下包商之零件備品管理
- 設計機台保養制具及流程改善以增進機台穩定性

福利制度 · 月薪36,000元

- 含勞保、健保、團保
- 實習結束後有機會轉正成正職員工
- 提供優質環境，完善多元設施



04/30 前搶得先機
掃描QR Code立即應徵

必備附件：個人履歷、歷年成績單
履歷加分：教授推薦信、英文檢定相關證明、其他證照

台積電 DNA 積因計畫

- D** evelop: 參與軟、硬實力的培養課程
N avigate: 與世界一流專家一起執行專案，探索先進技術！
A dvance Offer: 表現優異者將有機會獲得“預先聘書”（含研替）

實習職務

【工程領域】

研究與發展、IC設計、營運製造、品質與可靠性、資訊...等

【其他專業領域】

人資、財務、法務、企業規劃、資材暨風險管理...等

參加資格

大三（含）以上同學，將優先晉用碩博士生
 實習期間須具備學生身分

報名資訊：

- 1、詳細填寫履歷，含學歷、專業關鍵字與自傳等資訊。
- 2、自傳與專業關鍵字欄位有字數限制 (300~1000字)，請確認填寫字數，以免造成網頁無法成功送出。
- 3、若履歷欄位形式為下拉選單，請勿自行輸入資料，以免資料無法正確送出。

相關時程：

申請期間：即日起 至 2022 年 4 月 15 日

徵選期間：即日起 至 2022 年 5 月 31 日

實習期間：2022 年 7 月 4 日至 2022 年 9 月 2 日

* 更多實習職缺將陸續公布於官網



直接投遞實習履歷



基因計畫說明會



tsmc tsmc tsmc tsmc tsmc

2022



台積找人才



tsmc tsmc tsmc tsmc tsmc

2022台積電校園徵才活動

熱烈歡迎2022 應屆畢業生

線上徵才說明會 (特別加映場)

#資訊技術專場 #我的台積生活圈 #DNA積因計畫

積星聊天室 (也是線上)

#電機電子 #機械 #材料 #化學化工 #資工資管

世界上的每一個夢，都由我們來圓夢



台積找人才

職務背景參考表

職務/科系		電機 電子	物理 光電	材料 化工	機械 控制	資工 資管	其它 工程	商業 工管
營運技術	1 製程整合(PIE)	●	●	●				
	2 製程(Process Engineering)		●	●				
	3 設備(EE)	●			●		●	
	4 智慧製造(MFG/IMC)				●	●	●	●
	5 廠務(FD)	●		●	●		●	
	6 產品(Product Engineering)	●	●	●				
	7 先進封裝測試技術開發 (Testing)	●	●		●	●	●	
	8 模組副工程師(MAE)	●	●		●		●	

台積找人才

營運技術職類

製程工程師

(Process Engineer)

設備工程師

(Equipment Engineer)

模組副工程師

(Module Associate Engineer)

角色

第一線負責晶片製造

機台價值創造者

第一線機台守護者

職責

1. 改善機台製程參數的設定
2. 提升機台良率
3. 讓機台每單位時間產出增加，降低生產成本
4. 四大模組，流程順序為薄膜沈積、黃光微影製程、溼式與乾式蝕刻、熱製程與離子摻雜(擴散)

1. 提升機台產能效率
2. 精進及改造機台元件
3. 提升產品良率
4. 緊急支援機台保養維護(PM)
5. 值班(日班/小夜/大夜)

1. FDC/SPC/Defense系統異常判斷與停機處理
2. 救貨處理(Q-time/破片/傳送晶圓)
3. 機台保養維護
4. 通報廠區異常事件
5. 值班(日班/大夜/假日)

人才特質

團隊合作
邏輯思考
問題解決能力

創新實踐
溝通合作
精益求精

紀律至上
勇於表達

tsmc tsmc tsmc tsmc tsmc

台積找人才

營運技術職類

製程整合工程師

(Process Integration Engineer)

智慧製造工程師

(Intelligent Manufacturing Engineer)

廠務工程師

(Facility Engineer)

角色

重要協調者

第一線生產管理者

安全的守護神

職責

1. 確保晶片的品質、持續提升良率
2. 需與客戶溝通了解客製化的晶片應用需求。
3. 監控晶片的良率與缺陷，再與製程解決問題。

1. 藉由良好且精準派工提升機台生產效率
2. 帶領技術員團隊確保製造流程順暢運行，達成每日的產能目標

1. 自動的生產單位供應最高品質、最穩定的生產作業環境
2. 確保公司營運符合法規與外部稽核單位的規定
3. 保護人身安全，守護公司的營運資產

人才特質

英文與溝通能力
領導與問題解決能力

運用大數據分析
機器學習優化生產排程
領導力/溝通技巧

獨立作戰研究
分析並解決問題
縝密的心思發掘問題風險

tsmc tsmc tsmc tsmc tsmc

tsmc tsmc tsmc tsmc tsmc

2022

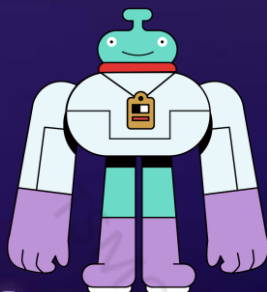


履歷傳送門



2022 校徵正職職務

職務/科系		電機 電子	物理 光電	材料 化工	機械 控制	資工 資管	其它 工程	商業 工管
營運 技術	1 製程整合(PIE)	●	●	●				
	2 製程(Process Engineering)		●	●				
	3 設備(EE)	●			●		●	
	4 智慧製造(MFG/IMC)				●	●	●	●
	5 廠務(FD)	●		●	●		●	
	6 產品(Product Engineering)	●	●	●				
	7 先進封裝測試技術開發 (Testing)	●	●		●	●	●	
	8 模組副工程師(MAE)	●	●		●		●	



04/30 前搶得先機

掃描QR Code立即應徵

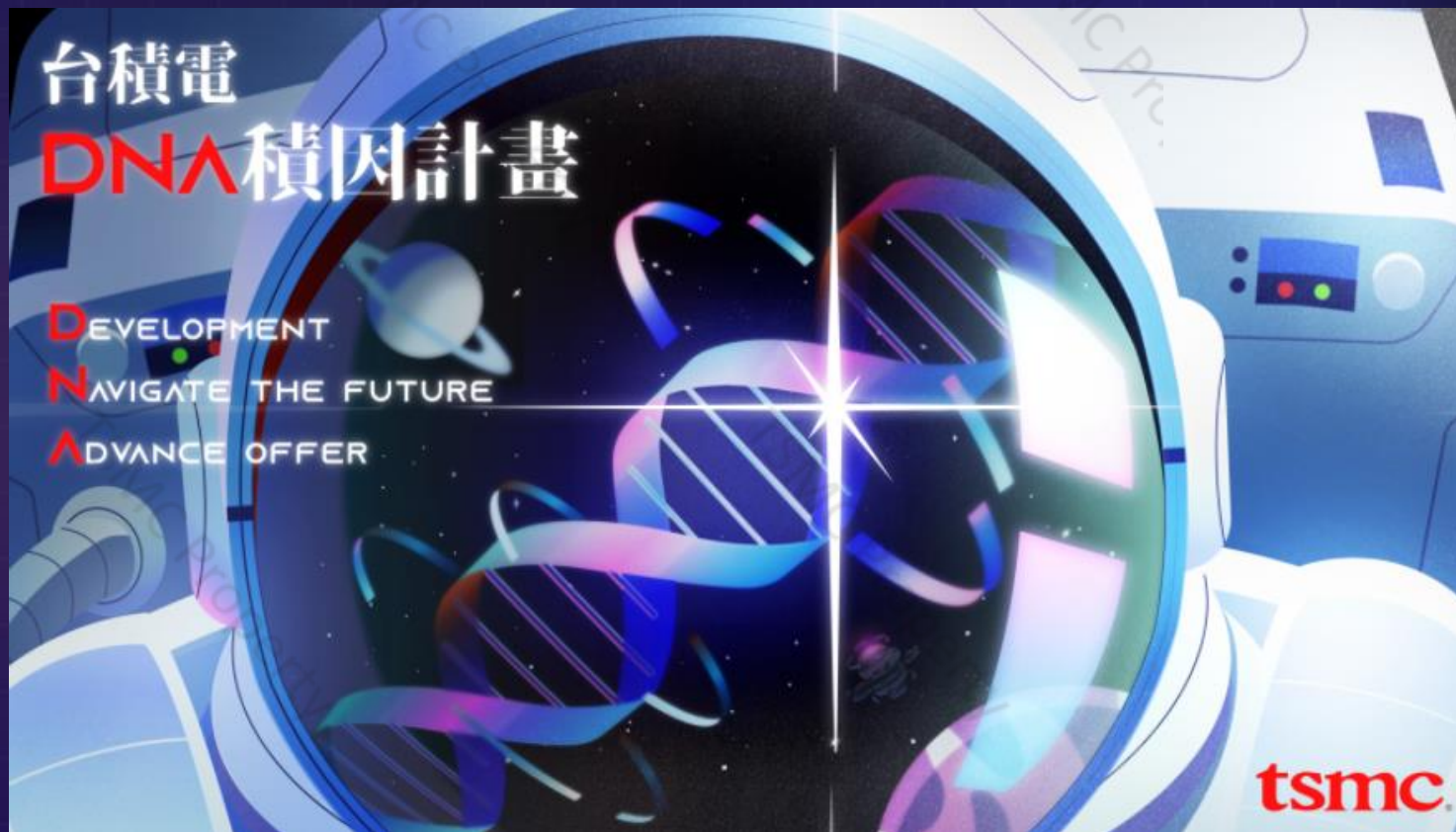
tsmc tsmc tsmc tsmc tsmc tsmc tsmc

DNA 暑期積因實習計畫

- 參加對象：
在學的碩博士生優先
(實習期間需有學生身分)
- 申請時程：即日起至 2022/4/15
- 面談時程：即日起至 2022/5/31
- 聘書通知：面談後3-4周內
- 實習時間：2022/7-8 (兩個月)
- 福利照顧：宿舍/交通車/餐補
- 預聘機會：實習評估後有機會取得
正職聘書



04/15 前搶得先機
掃描QR Code立即應徵



tsmc tsmc tsmc tsmc tsmc